

Erhöhtes Wärmespreizvermögen von Leiterplatten durch eingebettete Heat-Pipes



In diesem Beitrag wird das Einbetten von nicht klassischen Bauelementen zum Wärmetransport (Heat-Pipes) als eine mögliche Wärme-Management- Lösung für besonders dicht gepackte Baugruppen vorgestellt, bei denen die Abfuhr der Verlustleistung vorwiegend durch das Wärmespreizvermögen der Leiterplatte selbst bewerkstelligt werden muss. Thermische Simulationen und Messungen zeigen die Vorzüge der Einbett-Technologie. Grenzen und Lösungsvorschläge werden diskutiert. // In this study we demonstrate the embedding of non- classical heat conducting components (heat pipes) as a possible solution for heat management in tightly packed applications where heat spreading and heat guiding of the PCB itself can be of extreme impor- tance. Measurement results and simulations describe the advantages of the presented embedding techno- logy. Further, possible bottlenecks and proposed solutions are discussed.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 4,39 €

4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)